

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司\*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 0981)

中芯截至二零零六年三月三十一日止三个月业绩公布

- 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司(纽约交易所: SMI; 香港联交所: 981) ([中芯]或[本公司]) 于今日公布截至二零零六年三月三十一日止三个月的综合经营业绩。二零零六年第一季销售额由上一季度的 333,100,000 元上升 5.4%至 351,100,000 元。本公司的月产能增至 157,330 片 8 吋等值晶圆,二零零六年第一季的使用率为 95%。与二零零五年第四季的经营亏损 8,800,000 元相比,二零零六年第一季经营亏损下降至 6,000,000 元。与二零零五年第四季净亏损 15,000,000 元相比,二零零六年第一季的净亏损减少至 8,700,000 元。
- 以下为本公司于二零零六年四月二十八日就截至二零零六年三月三十一日止三个月的未经审核业绩在美国报章所作的报章公布全文。
- 本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1)条规定的披露责任于二零零六年四月二十八日作出本公布。

所有货币数字主要以美元列账,除非特别指明。

报告内的财务报表数额按美国公认会计原则厘定。

## 中芯二零零六年第一季业绩报告

### 概要

- 销售额由二零零五年第四季的 333,100,000 元升至二零零六年第一季的 351,100,000 元,升幅为 5.4%。
- 二零零六年第一季的经营亏损从二零零五年第四季的 8,800,000 元下降至 6,000,000 元
- 二零零六年第一季的净亏损从二零零五年第四季的 15,000,000 元下降至 8,700,000 元
- 二零零六年第一季的产能使用率增至 95%,二零零五年第四季为 93%。
- 二零零六年第一季的晶圆付运比二零零五年第四季增加 3.1%,至 388,010 片 8 吋等值晶圆。

- 二零零六年第一季的月产能从二零零五年第四季的 152,219 片 8 吋等值晶圆增至 157,330 片 8 吋等值晶圆。

中国上海—二零零六年四月二十八日—国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司（纽约交易所：SMI；香港联交所：981）（「中芯」或「本公司」）于今日公布截至二零零六年三月三十一日止三个月的综合经营业绩。二零零六年第一季销售额由上一季度的 333,100,000 元上升 5.4% 至 351,100,000 元。本公司的月产能增至 157,330 片 8 吋等值晶圆，二零零六年第一季的使用率为 95%。与二零零五年第四季的经营亏损 8,800,000 元相比，二零零六年第一季经营亏损下降至 6,000,000 元。与二零零五年第四季的净亏损 15,000,000 元相比，二零零六年第一季的净亏损减少至 8,700,000 元。

- 1、我很高兴地宣布，我们第一季的表现超出预期，第一季营收持续增加至 3 亿 5 千 1 百万，使得营运亏损降至 600 万。
- 2、我们 0.13 微米及其以下更先进产品的营收占了总营收的百分比增至 47%。0.15 和 0.13 微米及其以下技术的逻辑产品在逻辑项目营收比例，与第四季相比，分别从 8.6% 和 10.9% 显著提升到 14.5% 和 13.3%。我们相信该趋势将会持续，因为我们接到的 0.13 微米全流程产品订单明显增加，而第一个 90 纳米产品也开始投入生产。
- 3、我们的 NAND Flash 研发团队在第一季成功地试产了 2 gigabit NAND 快闪产品，并依计划在 6 月产出第一批工程样品，我们计划在今年 2006 年第四季开始量产。
- 4、我们的成都封装测试厂在第一季开始量产，使得中芯国际现在能够为我们的客户提供芯片制造的全套完整服务。
- 5、我们的太阳能计划进展顺利，且持续增进其能源转换率。我们计划在第二季投入量产。我们相信，随着我们事业计划进展，定能为股东创造更大价值。

电话会议 / 网上业绩公布详情

日期：二零零六年四月二十八日

时间：上海时间上午八时正

拨号及登入密码：美国 1-617-614-2714（密码：SMIC）或香港 852-3002-1672（密码：SMIC）。

二零零六年第一季业绩公布网上直播可于 [www.smics.com](http://www.smics.com) 网站「投资者关系」一栏收听。中芯网站在网上广播后为期十二个月提供网上广播录音版本连同本新闻发布的软拷贝。

## 有关中芯

中芯国际 (NYSE: SMI, HKSE: 0981.HK), 总部位于上海, 是一家国际型公司, 是世界领先的集成电路芯片代工厂之一, 向全世界客户提供 0.35 微米到 90 纳米及更先进工艺的芯片制造服务。公司 2000 年成立以来, 其位于上海及天津的四座 8 英寸芯片厂均已量产。另外, 其位于北京的中国第一家 12 英寸芯片厂也于 2005 年第一季度开始量产。中芯国际还在美国、欧洲、日本等地提供客户服务和设立销售办事处, 同时在香港设立了代表处。中芯国际拥有 2500 多名半导体行业的专家及技术骨干。中芯国际目前已经通过了 ISO9001 认证、ISO/TS16949 认证、OHSAS18001 认证、TL9000 认证、BS7799 认证以及 ISO14001 认证。如需更多信息, 敬请访问公司网站: <http://www.smics.com>

## 安全港声明

(根据 1995 私人有价证券诉讼改革法案)

本次新闻发布可能载有 (除历史资料外) 依据 1995 年美国私人有价证券诉讼改革法案的“安全港”条文所界定的「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述包括关于我们对来自 0.13 微米的销售额占总销售额的百分比以及 0.15 微米和 0.13 微米逻辑产品的销售额占逻辑产品销售额的百分比的预期的声明; 我们第一个 90 纳米产品开始量产的预期声明; 2 gigabit NAND 快闪产品量产目标日期以及我们太阳能模板计划的预期声明; 我们相信通过执行商业计划将增加股东价值的预期声明以及在“现金流量和资本支出”项下的 2006 年资本支出计划声明和“二零零六年第二季展望”项下的声明乃根据中芯对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯使用「相信」、「预期」、「计划」、「估计」、「预计」、「预测」及类似表述为该等前瞻性陈述之标识, 尽管并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。

该等前瞻性陈述乃反映中芯高级管理层根据最佳判断作出的估计, 存在重大已知及未知风险、不确定性, 以及其它可能导致中芯实际业绩、财政状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素, 包括 (但不限于) 与半导体行业周期及市场状况有关的风险、激烈竞争、中芯客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造生产量供给及最终市场的金融局势是否稳定。

投资者应考虑中芯呈交予美国证券交易委员会 (「证交会」) 的文件资料, 包括其于二零零五年六月二十八日以 20-F 表格形式呈交予证交会的年度报告, 特别是「风险因素」及「有关财政状况及经营业绩的管理层讨论及分析」两个部份、其于二零零四年三月八日以 A-1 表格形式呈交予香港联合交易所 (「香港联交所」) 的登记声明, 以及中芯可能不时向证交会及香港联交所呈交的该等其它文件, 包括 6-K 表格。其它未知或不可预知的因素亦可能会对中芯日后的业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于上述风险、不确定性、假设及因素, 本新闻

发布中提及的前瞻性事件可能不会发生。务请阁下注意，切勿过份依赖此等前瞻性陈述，此等陈述仅就本新闻发布中所载述日期（或如无有关日期，则为本新闻发布日期）的情况而表述。

除法律有所规定以外，中芯概不就因新资料、未来事件或其它原因引起的任何情况承担任何责任，亦不拟更新任何前瞻性陈述。

投资者联络资料：

Jimmy Lai

电话：86-21-5080-2000，内线：16088

[Jimmy\\_Lai@smics.com](mailto:Jimmy_Lai@smics.com)

Calvin Lau

电话：86-21-5080-2000，内线：16693

[Calvin\\_Lau@smics.com](mailto:Calvin_Lau@smics.com)

手机：+852-9435-2603

手机：+86-13636468590

Douglas Hsiung

电话：86-21-5080-2000，内线：12804

[Douglas\\_hsiung@smics.com](mailto:Douglas_hsiung@smics.com)

手机：86-13795272240

概要：

以千美元为单位（每股盈利和百分比除外）

	<a href="#">二零零六年 第一季度</a>	<a href="#">二零零五年 第四季度</a>	<a href="#">季度比较</a>	<a href="#">二零零五年 第一季度</a>	<a href="#">年度比较</a>

销售	351,138	333,052	5.4%	248,808	41.1%
销售成本	307,768	290,094	6.1%	233,696	31.7%
毛利	43,370	42,958	1.0%	15,112	187.0%
经营开支	49,335	51,756	-4.7%	37,086	33.0%
经营亏损	(5,965)	(8,798)	-32.2%	(21,974)	-72.9%
其它收入(支出)	(8,865)	(5,852)	51.5%	(8,012)	10.6%
所得税	14	152	-90.8%	9	60.5%
税后亏损净额	(14,844)	(14,802)	0.3%	(29,995)	-50.5%
少数股权	947	(176)	-	-	-
会计准则改变的累计影响	5,154	-	-	-	-
普通股持有人应占亏损	(8,743)	(14,978)	-41.6%	(29,995)	-70.9%
毛利率	12.4%	12.9%		6.1%	
经营利润率	-1.7%	-2.6%		-8.8%	
每股股份净亏损-基本/摊薄(1)	(\$0.0005)	(\$0.0008)		(\$0.0017)	
每股美国预托股份净亏损-基本/摊薄	(\$0.0239)	(\$0.0410)		(\$0.0831)	
付运晶圆(8吋等值)(2)	388,010	376,227	3.1%	284,912	36.2%
逻辑平均售价(3)	\$945	\$953	-0.8%	\$967	-2.3%
综合平均售价	\$862	\$855	0.8%	\$829	4.0%
简化平均售价(4)	\$905	\$885	2.3%	\$873	3.7%
产能使用率	95%	93%		85%	

附注:

(1) 基于二零零六年第一季加权平均普通股 18,278,000,000 股, 二零零五年第四季 18,251,000,000 股, 二零零五年第一季 18,054,000,000 股。

(2) 包括铜接连件

(3) 不包括铜接连件

(4) 销售总额/晶圆付运总数

- 二零零六年第一季销售额升至 351,100,000 元, 较二零零五年第四季的 333,100,000 元录得季度升幅 5.4%, 并较二零零五年第一季的 248,800,000 元录得年度升幅 41.1%。导致此等上升的主要因素如下:
  - 8 吋等值晶圆付运升至 388,010 片, 较二零零五年第四季的 376,227 片录得季度升幅 3.1%;
  - 综合平均售价季度增幅为 0.8%, 以及
  - 产能使用率增至 95%
- 销售成本从二零零五年第四季的 290,100,000 元增加 6.1%至二零零六年第一季的 307,800,000 元, 主要由于晶圆付运数量增加以及折旧费用提高。
- 二零零六年第一季毛利上升至 43,400,000 元, 较二零零五年第四季的 43,000,000 元录得季度升幅 1.0%; 较二零零五年第一季的 15,100,000 元录得年度升幅 187.0%
- 毛利率从二零零五年第四季的 12.9%降至二零零六年第一季 12.4%。
- 研发费用从二零零五年第四季的 25,000,000 元下降 17.5%至二零零六年第一季 20,600,000 元, 主要是由于收到政府给予研发活动的补贴。

- 一般行政费用（包括汇兑收益）从二零零五年第四季 9,800,000 元上升 19.8%至二零零六年第一季 11,700,000 元，主要由于坏帐准备、人事相关费用及税费增加。
- 销售及市场推广相关费用从二零零五年第四季 6,300,000 元下降 6.0%至二零零六年第一季 6,000,000 元。
- 所获无形资产摊销从二零零五年第四季的 10,600,000 元上升 3.6%至二零零六年第一季的 11,000,000 元。
- 经营亏损从二零零五年第四季的 8,800,000 元下降 32.2%至二零零六年第一季 6,000,000 元，二零零五年第一季的经营亏损为 22,000,000 元。
- 其它非营业性亏损由二零零五年第四季的 5,900,000 元上升 51.5%至二零零六年第一季的 8,900,000 元，主要是由于所占联营公司亏损增加以及上一季度发生一次性的固定资产销售。
- 二零零六年第一季的利息支出由二零零五年第四季的 11,800,000 元增加 3.5%至 12,200,000 元，主要是由于利率上升。
- 二零零六年第一季净亏损由二零零五年第四季净亏损 15,000,000 元下降 41.6%至 8,700,000 元，与二零零五年第一季净亏损 30,000,000 元相比下降 70.9%。
- 本公司记录了一笔金额为 5,200,000 元的一次性的贷记调整，此调整是基于采用财务会计准则理事会第 123R 号中有关股票报酬费用的会计准则改变的累计影响所致。

## 1. 收入分析

销售分析					
以应用分类	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季
计算机	36.0%	34.8%	33.7%	39.8%	36.8%
通讯	45.8%	43.8%	39.8%	40.4%	44.5%
消费	13.3%	16.6%	22.8%	15.2%	13.6%
其它	4.9%	4.8%	3.7%	4.6%	5.1%
以装置分类	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季
逻辑（包括铜连接件）	62.8%	65.3%	65.5%	58.9%	61.9%
DRAM (1)	32.4%	31.3%	31.0%	36.5%	33.0%
其它（光罩制造及探测等）	4.8%	3.4%	3.5%	4.6%	5.1%
以客户类别分类	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季
非厂房半导体公司	41.8%	43.2%	43.2%	42.2%	48.1%
集成装置制造商	52.8%	51.7%	52.8%	55.2%	49.6%
系统公司及其它	5.4%	5.1%	4.0%	2.6%	2.3%
以地区分类	二零零六年	二零零五年	二零零五年	二零零五年	二零零五年

	<u>第一季</u>	<u>第四季</u>	<u>第三季</u>	<u>第二季</u>	<u>第一季</u>
北美洲	43.5%	39.2%	42.9%	40.8%	40.4%
亚太区（不包括日本）	21.3%	28.2%	25.7%	26.3%	26.9%
日本	3.3%	3.6%	4.5%	6.0%	8.0%
欧洲	31.9%	29.0%	26.9%	26.9%	24.7%
<b>晶圆收入分析</b>					
各技术占晶圆销售额的百分比 (仅包括逻辑、记忆及铜接连件)	<u>二零零六年 第一季</u>	<u>二零零五年 第四季</u>	<u>二零零五年 第三季</u>	<u>二零零五年 第二季</u>	<u>二零零五年 第一季</u>
0.13 微米及以下	46.6%	42.9%	43.8%	44.5%	29.2%
0.15 微米	8.7%	5.2%	2.7%	2.5%	12.5%
0.18 微米	35.7%	42.3%	45.3%	40.7%	40.3%
0.25 微米	1.6%	3.3%	3.1%	3.9%	4.6%
0.35 微米	7.4%	6.3%	5.1%	8.4%	13.4%
各逻辑技术占逻辑晶圆销售额百分比 (1)	<u>二零零六年 第一季</u>	<u>二零零五年 第四季</u>	<u>二零零五年 第三季</u>	<u>二零零五年 第二季</u>	<u>二零零五年 第一季</u>
0.13 微米及以下 (2)	13.3%	10.9%	14.7%	12.6%	5.4%
0.15 微米	14.5%	8.6%	5.3%	4.8%	2.2%
0.18 微米	57.7%	65.3%	67.4%	59.4%	59.8%
0.25 微米	2.3%	4.8%	4.0%	7.1%	7.1%
0.35 微米	12.2%	10.4%	8.6%	16.1%	25.5%

附注:

(1) 不包括 0.13 微米铜接连件

(2) 代表来自于全流程制造晶圆的销售收入

- 与二零零五年第四季相比，二零零六年第一季应用于通讯类产品的芯片的销售增长速度快于其它应用领域。
- 二零零六年第一季源自北美及欧洲客户的销售额占总销售额的百分比与二零零五年第四季度的 39.2%及 29.0% 相比，上升至 43.5%及 31.9%。
- 二零零六年第一季 0.13 微米及以下技术晶圆的销售额占晶圆销售额百分比与二零零五年第四季度的 42.9%及二零零五年第一季度的 29.2%相比上升至 46.6%。
- 二零零六年第一季 0.13 微米及以下技术逻辑晶圆的销售额占逻辑晶圆销售额的百分比与二零零五年第四季度的 10.9%及二零零五年第一季度的 5.4%相比上升至 13.3%。

• **产能:**

<u>厂 / (晶圆尺寸)</u>	<u>二零零六年第一季<sup>(1)</sup></u>	<u>二零零五年第四季<sup>(1)</sup></u>
一厂 (8 吋)	43,000	43,441
二厂 (8 吋)	47,954	46,451
四厂 (12 吋)	30,220	27,368
七厂 (8 吋)	15,000	15,000
每月晶圆装配总产能		
	136,174	132,260

铜接连件:			
三厂 (8 吋)		21, 156	19, 959
每月铜接连件总产能		21, 156	19, 959

附注:

(1) 期终每月晶圆计, 8 吋等值

- 截至二零零六年第一季度末, 每月产能增加至 157, 330 片 8 吋等值晶圆。

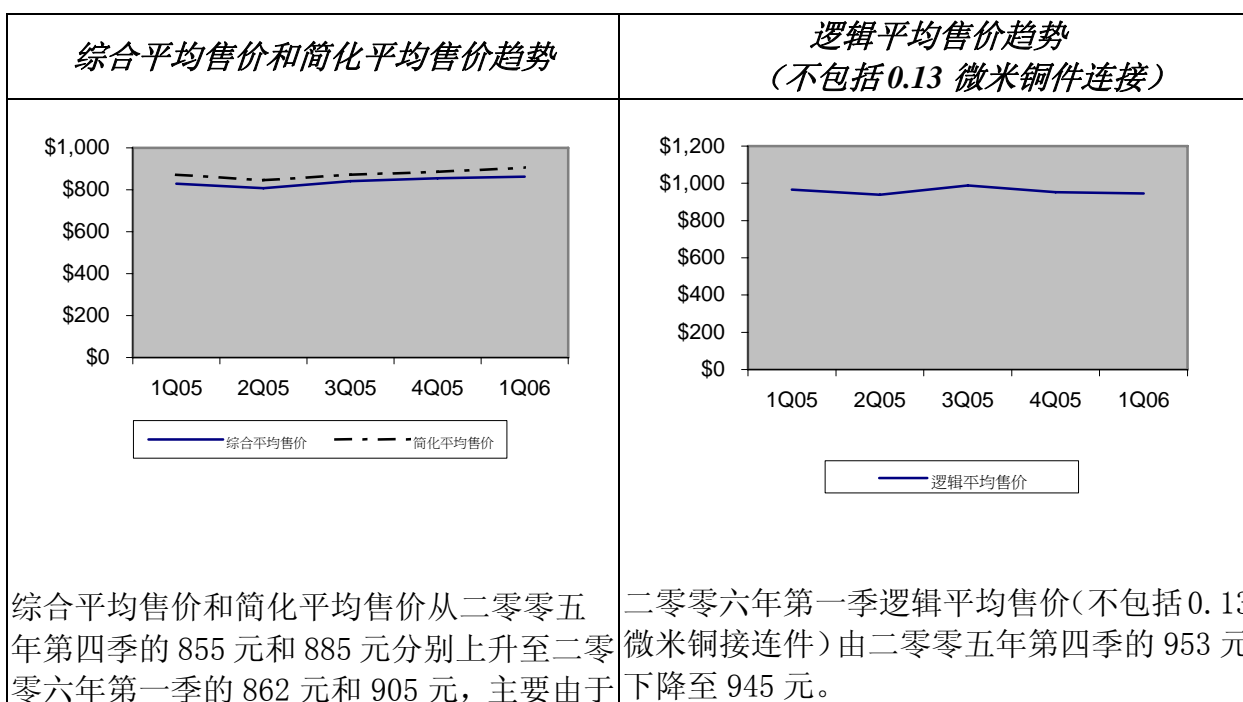
付运及使用率:

8 吋晶圆	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季
付运晶圆 (包括铜接连件)	388, 010	376, 227	355, 664	330, 499	284, 912
使用率 <sup>(1)</sup>	95%	93%	92%	87%	85%

附注:

(1) 产能使用率按输出晶圆总额除以估计产能计算

- 二零零六年第一季晶圆付运增加至 388, 010 片 8 吋等值晶圆, 分别较二零零五年第四季的 376, 227 片 8 吋等值晶圆及二零零五年第一季度的 284, 912 片 8 吋等值晶圆分别录得季度升幅 3. 1% 及年度升幅 36. 2%。
- 使用率上升至 95%。





整个 DRAM 代工业价格环境的调涨	
--------------------	--

## 2. 详细财务分析

### 毛利分析

以千美元计	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	季度比较	二零零五年 第一季	年度比较
销售成本	307,768	290,094	6.1%	233,696	31.7%
折旧	189,054	176,545	7.1%	145,307	30.1%
其它制造成本	118,714	113,549	4.5%	88,389	34.3%
毛利	43,370	42,958	1.0%	15,112	187.0%
毛利率	12.4%	12.9%		6.1%	

- 销售成本从二零零五年第四季的 290,100,000 元增加 6.1%至二零零六年第一季的 307,800,000 元，主要由于晶圆付运的增加以及折旧费用的提高。
- 二零零六年第一季毛利为 43,400,000 元，与二零零五年第四季的 43,000,000 元相比录得季度升幅 1.0%，与二零零五年第一季的 15,100,000 元相比录得年度升幅 187.0%。
- 毛利率从二零零五年第四季的 12.9%下降至二零零六年第一季 12.4%。

### 经营开支分析

以千美元计	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	季度比较	二零零五年 第一季	年度比较
总经营开支	49,335	51,756	-4.7%	37,086	33.0%
研究及开发	20,593	24,964	-17.5%	15,956	29.1%
一般及行政	11,749	9,803	19.8%	8,164	43.9%
销售及市场推广	5,970	6,349	-6.0%	3,097	92.7%
取得无形资产摊销	11,023	10,640	3.6%	9,869	11.7%

- 总经营开支从二零零五年第四季的 51,800,000 元下降至 49,300,000 元，录得季度降幅 4.7%。
- 研发费用从二零零五年第四季的 25,000,000 元下降 17.5%至二零零六年第一季 20,600,000 元，主要是由于收到政府给予研发活动的补贴。。
- 一般行政费用(包括汇兑收益)从二零零五年第四季 9,800,000 元上升 19.8%至二零零六年第一季 11,700,000 元，主要是由于坏帐准备、人事相关费用及税费增加。
- 销售及市场推广相关费用从二零零五年第四季 6,300,000 元下降 6.0 %至二零零六年第一季 6,000,000 元。
- 取得无形资产摊销从二零零五年第四季 10,600,000 元上升 3.6%至二零零六年第一季 11,000,000 元。

### 其它收入（支出）

以千美元计	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	季度比较	二零零五年 第一季	年度比较
其它收入(支出)	(8,865)	(5,852)	51.5%	(8,012)	10.6%
利息收入	4,595	4,120	11.5%	1,928	138.3%
利息支出	(12,201)	(11,792)	3.5%	(7,688)	58.7%
其它，净额	(1,259)	1,820	-	(2,252)	-44.1%

- 二零零六年第一季其它非营业性亏损为 8,900,000 元，相较于二零零五年第四季度亏损 5,900,000 元上升了 51.5%。
- 二零零六年第一季的利息支出由二零零五第四季的 11,800,000 元增加 3.5%至 12,200,000 元，主要是由于利率上升。

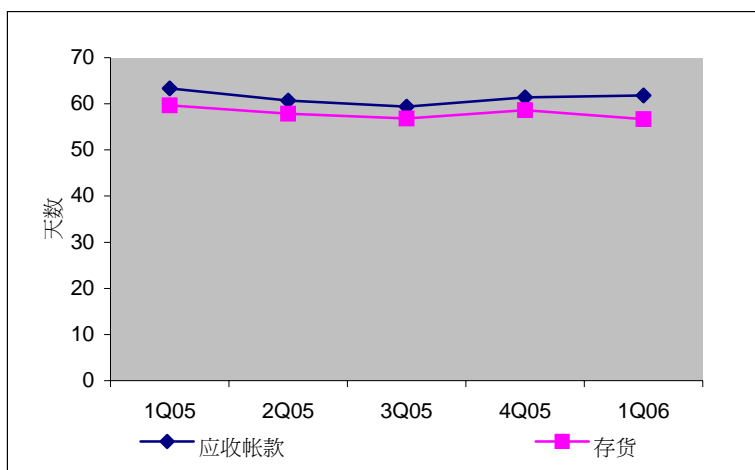
### 3. 流动资金

以千美元计	二零零六年第一季	二零零五年第四季
现金及现金等价物	485,121	585,797
短期投资	3,525	13,796
应收账款	241,020	241,334
存货	196,585	191,238
其它	16,363	15,300
总流动资产	942,614	1,047,465
应付账款	286,884	262,318
短期借款	211,608	265,481
长期借款的即期部份	246,081	246,081
其它	119,057	122,158

总流动负债	863,630	896,038
现金比率	0.6x	0.7x
速动比率	0.9x	0.9x
流动比率	1.1x	1.2x

•

### 应收账款 / 存货的各日走势



### 资本结构

以千美元计	二零零六年第一季	二零零五年第四季
现金及现金等价物	485,121	585,797
短期投资	3,525	13,796
长期票据即期部分	29,493	29,242
长期票据	104,140	103,254
短期借款	211,608	265,481
长期借款的即期部份	246,081	246,081
长期借款	431,504	494,556
总借款	889,193	1,006,118
现金净额	(534,180)	(539,021)
股东权益	3,019,086	3,026,099
总借款对权益比率	29.5%	33.3%

#### 4. 现金流量及资本开支

以千美元计	二零零六年第一季	二零零五年第四季
亏损净额	(8,743)	(14,978)
折旧及摊销	210,595	201,358
购入无形资产摊销	11,024	10,640
现金变动净额	(100,676)	9,030

#### 资本开支计划

- 二零零六年第一季资本开支为 225,000,000 元。
- 计划下的二零零六年资本开支总额将约为 1,100,000,000 元，并将根据市场情况作相应调整。

#### 5. 二零零六年第二季指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性，部分已于之前的安全港声明中阐明。

- 销售额预期比二零零六年第一季度增长 2%-5%。
- 使用率预期约为 93%至 95%。
- 毛利率预计将维持二零零六年第一季度的水平。
- 经营开支相对销售的百分比预计维持二零零六年第一季度的水平。
- 非经营利息支出预期约至 11,000,000 元左右。
- 资本开支预期约介于 400,000,000 元至 450,000,000 元之间。
- 折旧及摊销预期约介于 235,000,000 至 240,000,000 元之间。

#### 6. 近期公布

- 中芯国际和 Cadence 提供新模拟混合信号参考流程用以加速设计公司的芯片设计。（二零零六年四月十三日）
- 公布 2005 年年度业绩。（二零零六年三月二十九日）

- 中芯国际参加中国 2006 年半导体展览会。（二零零六年三月二十一日）
- 中芯国际与杭州士康联合推出对讲机射频收发器芯片。（二零零六年三月二十一日）
- 中芯国际荣获“索尼绿色伙伴”认证。（二零零六年三月十七日）
- 中芯国际成都公司封装测试厂开业典礼。（二零零六年三月十七日）
- 中芯国际与 TTSILICON 合作拓展其对英国和北欧洲半导体设计公司的支持。（二零零六年三月十四日）
- 澄清公告。（二零零六年二月八日）
- 非执行董事之离任及委任。（二零零六年二月七日）
- 中芯国际公布 2005 年第四季经营业绩。（二零零六年二月六日）
- 中芯国际为杭州国芯制造生产之芯片赢得“重大技术发明奖”。（二零零六年一月十八日）
- 中芯国际与 ARC 联合将可调式微处理器引入中国。（二零零六年一月九日）
- 中芯国际采用明导科技Eldo 仿真器于 0.13 微米及以下工艺的模拟电路设计中。（二零零六年一月六日）
- 英飞凌与中芯国际将合作协议扩展至 90 奈米生产领域。（二零零六年一月六日）
- 中芯国际与 SAIFUN 拓展 NROM 技术转让协议。（二零零六年一月四日）

上述公布详情请参阅中芯网站。

[http://www.smics.com/website/enVersion/Press\\_Center/pressRelease.jsp](http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp)

中芯财务资料

合并资产负债表  
(美元)

	截至以下日期止	
	二零零六年三月三十一日 (未经审核)	二零零五年十二月三十一日 (经审核)
<b>资产</b>		
流动资产:		
现金及现金等价物	485,120,565	585,796,887
短期投资	3,525,210	13,795,859
应收账款, 已扣除拨备(二零零六年三月三十一日为 3,155,788 元, 二零零五年十二月三十一日为 1,091,340 元)	241,020,392	241,333,914
存货	196,584,559	191,237,636
预付款项及其它流动资产	16,363,507	15,300,591
<b>流动资产合计</b>	<b>942,614,233</b>	<b>1,047,464,887</b>
土地使用权, 净额	41,392,218	34,767,518
厂房及设备, 净额	3,286,544,385	3,285,631,131
购入无形资产, 净额	191,933,630	195,178,898
长期投资	16,762,335	17,820,890
其它非流动资产	2,342,957	2,552,407
<b>资产合计</b>	<b>4,481,589,758</b>	<b>4,583,415,731</b>
<b>负债及股东权益</b>		
流动负债:		
应付帐款	286,884,436	262,318,432
预提费用及其它流动负债	89,469,845	92,916,030
短期借款	211,607,902	265,481,082
长期票据的即期部份	29,492,874	29,242,001
长期借款的即期部份	246,081,155	246,080,580
应付所得税	93,634	-
<b>流动负债合计</b>	<b>863,629,846</b>	<b>896,038,125</b>
长期负债:		
长期票据	104,140,277	103,254,436
长期借款	431,504,129	494,556,385
其它长期应付款	25,395,010	24,686,398
<b>长期负债合计</b>	<b>561,039,416</b>	<b>622,497,219</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,424,669,262</b>	<b>1,518,535,344</b>
<b>承诺</b>		

少数股权	37,834,500	38,781,863
股东权益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份为 50,000,000,000 股，截止二零零六年三月三十一日已发行股份为 18,318,402,283 股，未发行的股份为 18,301,680,867 股。	7,327,361	7,320,674
认股权证	32,387	32,387
额外缴入股本	3,268,265,625	3,291,407,447
应收股东票据	-	-
累计其它综合盈余	122,675	138,978
递延股票报酬	-	(24,881,919)
累计亏绌	(256,662,052)	(247,919,043)
<b>所有股东权益合计</b>	<b>3,019,085,996</b>	<b>3,026,098,524</b>
<b>总负债及股东权益合计</b>	<b>4,481,589,758</b>	<b>4,583,415,731</b>

合并营运报表  
(美元)

	截至以下日期止三个月	
	二零零六年三月三十一日 (未经审核)	二零零五年十二月三十一日 (未经审核)
销售额	351,137,952	333,051,413
销售成本	307,767,802	290,093,917
<b>毛利</b>	<b>43,370,150</b>	<b>42,957,496</b>
经营费用:		
研究和开发	20,592,655	24,963,969
一般管理	11,748,899	9,803,070
销售和市场推广	5,970,146	6,348,944
购入无形资产摊销	11,023,590	10,639,905
<b>经营费用总额</b>	<b>49,335,290</b>	<b>51,755,888</b>
<b>经营亏损</b>	<b>(5,965,140)</b>	<b>(8,798,392)</b>
其它收入(支出):		
利息收入	4,595,384	4,119,974
利息支出	(12,201,407)	(11,791,740)
其它净额	(200,656)	2,214,436
<b>其它收入(支出), 净额</b>	<b>(7,806,679)</b>	<b>(5,457,330)</b>
<b>税前亏损净额</b>	<b>(13,771,819)</b>	<b>(14,255,722)</b>
所得税	13,985	151,636
少数股权	947,364	(175,970)
应占联营公司亏损	(1,058,555)	(395,013)
会计准则改变的累计影响	5,153,986	
<b>净亏损</b>	<b>(8,743,009)</b>	<b>(14,978,341)</b>
每股股份会计调帐前亏损净额, 基本/摊薄	(0.0008)	(0.0008)
每股股份会计准则改变累计影响金额	0.0003	-
每股股份亏损净额, 基本/摊薄	(0.0005)	(0.0008)
每股美国预托股份会计调帐前亏损净额	(0.0380)	(0.0410)



每股美国预托股份会计准则改变累计影响金额	0.0141	-
----------------------	--------	---

每股美国预托股份亏损净额，基本/摊薄 (1)	(0.0239)	(0.0410)
------------------------	----------	----------

用作计算基本/摊薄每股普通股收入 净额的股份（以百万计）	18,278	18,251
---------------------------------	--------	--------

\* 递延股票报酬摊销乃关于：

销售成本	3,127,678	2,937,243
研究和开发	1,281,330	1,217,349
一般管理	1,211,830	1,681,284
销售和市场推广	543,929	649,418
总计	6,164,767	6,485,294

(1) 每股美国预托股份等于 50 股普通股。

合并现金流量表  
(美元)

	截至以下日期止三个月	
	二零零六年三月三十一日	二零零五年十二月三十一日
	(未经审核)	(未经审核)
<b>经营活动:</b>		
普通股持有人应占亏损	(8,743,009)	(14,978,341)
会计准则改变的累计影响	(5,153,986)	-
净亏损	<u>(13,896,995)</u>	<u>(14,978,341)</u>
净收入至经营活动所得(所耗)现金净额对账的调整:		
少数股权	(947,364)	175,970
出售厂房及设备的收益(亏损)	1,018	(1,776,513)
(冲销)呆账拨备	-	807,249
折旧及摊销	210,595,208	201,358,428
购入无形资产摊销	11,023,590	10,639,905
递延股票报酬摊销	6,164,767	6,485,294
非现金长期票据利息费用	1,465,312	2,037,607
长期投资亏损	1,058,555	519,284
营运资产及负债的变动:		
应收账款	313,522	(29,318,399)
存货	(5,346,923)	(8,387,032)
预付款及其它流动资产	(853,466)	(5,937,696)
应付账款	3,521,334	(5,242,931)
预提费用及其它流动负债	(10,144,265)	17,817,242
应付所得税	93,634	-
<b>经营活动所得现金净额</b>	<b><u>203,047,927</u></b>	<b><u>174,200,067</u></b>
<b>投资活动:</b>		
购入厂房及设备	(197,518,652)	(208,688,953)
购买所获无形资产	(1,439,000)	(3,749,999)
购入短期投资	-	(12,183,063)
长期投资已付款项	-	-
出售短期投资	10,250,212	3,983,468
出售生活园区所得款项	-	7,948,629
处置固定资产所得款项	1,167,914	2,630,000
<b>投资活动所耗现金净额</b>	<b><u>(187,539,526)</u></b>	<b><u>(210,059,918)</u></b>
<b>融资活动:</b>		
短期借款所得款项	65,125,158	64,320,752
长期借款所得款项	59,988,601	49,909,022
偿还长期借款支付的款项	(123,040,282)	-
偿还长期票据支付的款项	-	(5,000,000)
偿还短期借款支付的款项	(118,998,338)	(65,347,912)
行使雇员购股权所得款项	736,003	762,710

收取应收雇员票据	-	247,137
<b>融资活动所得现金净额</b>	<b>(116,188,858)</b>	<b>44,891,709</b>
汇率变动的影晌	4,135	(1,562)
<b>现金及现金等价物增加(减少)净额</b>	<b>(100,676,322)</b>	<b>9,030,296</b>
现金及现金等价物—二零零五年十二月三十一日	585,796,887	576,766,591
<b>现金及现金等价物—二零零六年三月三十一日</b>	<b>485,120,565</b>	<b>585,796,887</b>

于本公布刊发日期，本公司董事分别有董事会主席及独立非执行董事王阳元、执行董事张汝京、非执行董事姚方、独立非执行董事徐大麟、周延鹏、川西刚、萧崇河及陈立武。

承董事会命

中芯国际集成电路制造有限公司

首席执行官

张汝京

中国 上海，二零零六年四月二十八日

\* 仅供识别